

# はんだ・微細接合部会 シンポジウム

## パワーデバイス／パワーモジュールにおける微細接合技術

開催期日：平成23年9月27日（火）

開催場所：エッサム神田ホール(3階) (神田)

開催趣旨：来るべき電気自動車の量産化時代に向け、次世代パワーデバイスの研究開発が進められています。次世代パワーデバイスでは、既存のSi半導体が変わりSiC半導体が導入される予定で、その導入により大電流化が可能になり使用温度も高温化します。そのため、パワーデバイス用の微細接合にも、大電流・高温化に対応した新たな接合材料、プロセス、放熱技術および信頼性評価技術などの研究開発が必要です。そこで、今回は省エネルギー技術の先進役たるパワーデバイスに関する講演を企画させていただきました。環境エコ社会の実現に向けた優しい製品・技術開発の一助となることを期待しております。皆様のご参加を心からお待ち申し上げます。

主催：社団法人 日本溶接協会 はんだ・微細接合部会 技術委員会 微細接合技術分科会

協賛：社団法人 エレクトロニクス実装学会 電子部品・実装技術委員会 / 先進実装技術研究会

後援：社団法人 電子情報技術産業協会

### 【参加申込方法】

申込書(コピー可)に必要事項を記入し、下記申込先に郵送またはファックスでお送り下さい。受付後、折り返し参加証をファックスで送付いたしますので、シンポジウム当日は必ず参加証をお持ち下さい。

参加定員：定員90名(定員になり次第締め切ります。)

参加費用：(会員)12,000円、(非会員)18,000円 / 1名(資料代および消費税を含む)

振込手数料は、各自ご負担下さい。

会員とは、日本溶接協会 本部団体会員(<http://www-it.jwes.or.jp/kain/kaindsp.jsp>)およびエレクトロニクス実装学会会員(<http://www.e-jisso.jp/support/index.html>)です。

日本溶接協会 はんだ・微細接合部会 部会員およびエレクトロニクス実装学会 電子部品・実装技術委員会委員の参加費用につきましては、別途各社委員へお問合せ下さい。

振込先：三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金口座 146921 (社)日本溶接協会

参加費用は上記の口座にご送金下さい。また、納入された参加費は返却致しかねますのでご了承下さい。銀行口座への振込をもって領収にかえさせていただきます。

なお、参加費用の振り込みが、シンポジウム当日以後になる場合は、必ず申込書に振込予定日をご記入下さい。

お申込先：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-11 (社)日本溶接協会

担当：木口明浩 TEL：03-3257-1524 FAX：03-3255-5196

## 【プログラム内容】

午前の部：

座長：ソニー（株）荒金 秀幸 氏

10:30-10:35 開会挨拶 はんだ・微細接合部会 技術委員会 委員長 竹本 正 氏

10:35-11:15 「SiC パワーデバイスを活用した高パワー密度変換器-高温接合技術の現状と課題-」  
技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構 松井 康平 氏

11:15-11:55 「環境・エネルギー問題に取り組むパワーエレクトロニクスにおける接合技術への期待」  
富士電機（株）海田 英俊 氏

11:55-13:00

昼 食・休 憩

午後の部（Part1）

座長：（株）村田製作所 高岡 英清 氏

13:00-13:35 「鉛フリーはんだ代替低温焼結接合の最前線」  
大阪大学大学院 廣瀬 明夫 氏

13:35-14:10 「薄膜積層化技術を利用した高温鉛フリー接合技術」  
（株）東芝 高橋 利英 氏

14:10-14:45 「高温はんだ代替銅ナノ粒子ペーストの接合強度」  
大阪大学接合科学研究所 西川 宏 氏

14:45-15:00

休 憩

午後の部（Prat 2）座長： 実装技術 NPO 法人 サーキットネットワーク 本多 進 氏

15:00-15:35 「高耐熱・低 CTE ポリイミドフィルムと実装基板への応用」  
東洋紡績（株）前田 郷司 氏

15:35-16:10 「複合放熱部材におけるパーコレーション理論の適用と高熱伝導材料の開発」  
電気化学工業（株）門田 健次 氏

16:10-16:45 「銅／樹脂密着性に及ぼす実装プロセスの影響」  
三菱電機（株）井高 志織 氏

16:45-16:50 閉会挨拶 TDK(株)土門 孝彰 氏 エレクトロニクス実装学会 先進実装技術研究会主査

シンポジウム企画：（社）日本溶接協会はんだ・微細接合部会微細接合技術分科会、

（社）エレクトロニクス実装学会・電子部品実装技術委員会先進実装技術研究会／電子部品技術研究会

9/27(火) はんだ・微細接合部会 シンポジウム 申込書  
 ~パワーデバイス/パワーモジュールにおける微細接合技術~

平成 年 月 日

ふりがな 氏名			
会社名/所属			
所在地	〒		
TEL		FAX(必須)	
e-mail			
振込予定日			
受講料 ( ) 円			

記入頂いた個人情報は「個人情報の保護に関する法律」に則り、日本溶接協会が定めた「個人情報保護方針」に従って管理いたします。詳細につきましては、日本溶接協会ホームページ(<http://www.jwes.or.jp/>)よりご覧下さい。

会場エッサム神田ホールへのアクセス

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-2-2 TEL : 03-3254-8787

JR 神田駅 東口 徒歩 1 分/東京メトロ銀座線 神田駅 3 出口前 ( 雨でも傘不要 )( JR 神田駅利用の方も、東京メトロ神田駅 3 出口 経由出来ます。)

